

2014-2015年全球及中国硬质PCB行业研究报告

《2014-2015年全球及中国硬质PCB行业研究报告》包含以下内容：

- 1、PCB产业分析
- 2、PCB下游市场分析
- 3、PCB厂家横向对比
- 4、35家典型PCB厂家研究

- 2014年对大部分PCB厂家来说都是美好的一年，整个PCB产业产值达到596亿美元，比2013年增长3.7%，是自2011年以来增长最快的一年。展望2015年，大宗商品暴跌，尤其铜价大跌，将大大降低PCB厂家的原材料成本，PCB厂家的利润率有望继续提高。

- 2014年关键的PCB制造地区，欧元、台币和日元都显著贬值，而韩元反而升值，这不仅严重打击了韩国PCB企业的竞争力，也让韩国PCB企业面临利润下滑。韩国PCB企业无一例外收入和利润率全面下滑，即使龙头厂家三星旗下的SEMCO也不例外，PCB业务收入下滑2.4%，而IC Carrier业务下滑19%，营业利润率从大约9%跌到不足1%。

- 台湾企业和欧洲企业则受益于货币贬值，利润率大增。日本企业由于一半以上的生产基地都位于海外，因此并未从日元贬值中获益，但还是比韩国企业好不少。

-

- 2014年硬质PCB领域HDI仍然是主要增长动力，预计2015年仍然能维持成长。由于手机屏幕变大，带动手机PCB板面积也变大，为了保持手机轻薄，更先进的Anylayer HDI需求大增。Anylayer HDI工艺耗费工时长，消耗产能大，加上日本松下退出Anylayer HDI领域，各大PCB厂家都在2015年扩展Anylayer HDI产能。2014年HDI PCB 业务收入增长最大的是台湾的Compeq，增长28.3%，达到6.9亿美元，与龙头厂家Unimicron只有一步之遥，Compeq拥有苹果和小米两大客户，业绩极佳。
- 2014年另一个亮点是服务器用PCB，随着网络经济的进一步深入，大数据时代到来，以及资金疯狂流入网络新经济，服务器需求火爆。服务器用PCB板要求高Tg低Loss,层数越来越高，最高达28层，这也使得服务器PCB的单价从2009年开始一直在上升。专注于服务器PCB的企业如台湾的楠梓电和ACCL取得了不错的成绩，楠梓电子收入增长20%，ACCL收入增长27%。
- 光电板领域，LED照明拉动散热良好的金属PCB需求，擅长金属PCB的台湾T.P.T、GIA TZOONG，中国大陆的景旺都有不错的增长。汽车PCB也表现可以。
- 2014年PCB行业最大事件是TTM与Viasystems合并，合并后的企业是绝对的硬板PCB第一名，总收入在25亿美元左右。TTM擅长手机和网络通讯领域，Viasystems则擅长汽车和工业领域，两者完美互补。



2012-2014年全球PCB硬板厂家收入前40名

		2012	2013	2014
TRIPOD	Taiwan	1326	1377	1388
TTM	USA	1349	1368	1398
Compeq	Taiwan	783	1051	1158
Viasystems	USA	967	1008	1028
Hannstar board	Taiwan	1112	976	958
Unimicron	Taiwan	1049	889	918
ZDT	Taiwan	908	871	850
Kingboard PCB	China HK	935	860	830
MEIKO	Japan	759	818	860
AT&S	Austria	698	780	838
CMK	Japan	908	730	750
SEMCO	South Korea	792	676	680
Chin Poon Industry	South Korea	595	658	738
WUS Group	Taiwan	644	658	650
T.P.T	Taiwan	722	650	750
MULTEK	USA	650	610	608
Gold Circuit Electronics	Taiwan	509	600	608
IBIDEN	Japan	455	580	630
Unitech PCB	Taiwan	433	480	478
ISU PETASYS	South Korea	390	450	508
HITACHI CHEMICAL	Japan	494	430	420
Shennan Circuits	China Mainland	345	423	451
Ellington	ChinaMainland	440	419	426
LG INNOTEK	South Korea	408	390	392
Founder Technology PCB	China Mainland	366	378	380
Dynamic Electronics	Taiwan	372	370	372
NANYA PCB	Taiwan	350	360	378
KYODEN	Japan	386	322	325
DAEDUCK GDS	South Korea	350	320	330
KYOCERA Circuit	Japan	412	350	420
REDBOARD	China HK	290	340	380
Wuzhou Group	China Mainland	270	296	308
DAP	South Korea	295	290	270
DAEDUCK ELECTRONICS	South Korea	280	290	270
Shirai Denshi	Japan	281	260	260
CCTC	China Mainland	286	277	270
Gul Technologies	Singapore	267	261	230



报告目录

第一章、PCB产业概况

- 1.1、全球PCB产业产值
- 1.2、PCB产业近况与未来趋势
- 1.3、台湾PCB产业
- 1.4、中国大陆PCB产业
 - 1.4.1、中国大陆PCB产业规模
 - 1.4.2、中国大陆PCB政策
- 1.5、大陆PCB厂家排名
- 1.6、欧洲PCB产业
- 1.7、北美PCB产业
- 1.8、日本PCB产业

第二章、PCB下游市场

- 2.1、全球手机市场
- 2.2、全球智能手机市场
- 2.3、中国手机市场
- 2.4、平板电脑市场
- 2.5、笔记本电脑市场

第三章、PCB产业分析

- 3.1、PCB技术趋势
 - 3.1.1、手机PCB厂家排名
 - 3.1.2、手机PCB配套关系
- 3.2、内存模块PCB
- 3.3、光电板
- 3.4、汽车电子PCB
- 3.5、笔记本电脑PCB
- 3.6、全球PCB厂家排名

第四章、主要PCB厂家研究

- 4.1、欣兴
- 4.2、华通
- 4.3、瀚宇博德
- 4.4、金像电子
- 4.5、健鼎
- 4.6、名幸MEIKO
- 4.7、CMK
 - 4.7.1、无锡希门凯
 - 4.7.2、瑞升科技
 - 4.7.3、旗利得电子
- 4.8、IBIDEN
- 4.9、大德电子
- 4.10、TTM



- 4.11、耀华
- 4.12、AT&S
- 4.13、建滔
 - 4.13.1、依利安达
 - 4.13.2、科惠线路板
 - 4.13.3、扬宣电子Express Electronics
- 4.14、SIMMTECH
- 4.15、志超T.P.T
- 4.16、依顿电子
- 4.17、敬鹏
- 4.18、LG INNOTEK
- 4.19、SEMCO
- 4.20、方正电路板
- 4.21、高德电子
- 4.22、定颖
- 4.23、惠亚
- 4.24、南亚电路板
- 4.25、深南电路
- 4.26、沪士电子
- 4.27、超声电子
- 4.28、臻鼎ZDT
- 4.29、MULTEK
- 4.30、景硕
- 4.31、SHINKO
- 4.32、ISU PETASYS
- 4.33、KYOCERA CIRCUIT SOLUTIONS
- 4.34、景旺电子KINWONG
- 4.35、博智电子



图表目录

- 2001-2015年PCB产业产值
- 1980-2001年全球PCB产值
- PCB产业链
- 2009-2015年PCB产业收入分布（分技术）
- 2013年全球PCB产值by layer
- 2013-2015年全球PCB产业收入地域分布
- 2012-2014年全球PCB产业收入地域分布
- 2010-2013年台湾PCB产业收入产品分布
- 2010-2011年中国大陆PCB企业投资结构
- 2011-2013年大陆PCB产业产值技术分布
- 2013年大陆PCB厂家收入排名
- 2013 European PCB Production by End Market
- 2013年欧洲PCB厂家收入国别分布
- 2000-2013年欧洲PCB厂家收入国别分布
- 2009-2013年欧洲主要PCB厂家季度收入
- 2005-2017年欧洲PCB厂家产值增幅
- 2013年欧洲TOP50 -PCB厂家
- 2008年1季度-2014年1季度北美主要PCB厂家收入
- 2005-2017年北美PCB产值增幅
- 2001-2014年日本PCB产值地域分布



- 2014年日本PCB产值By layer
- 2007-2015年全球手机出货量
- 2011-2014年全球3G/4G手机出货量地域分布
- Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- 2014年3季度全球十大手机厂家出货量
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013 (Thousands of Units)
- 2013-2015年全球Top 13智能手机厂家出货量
- 2014年3季度主要智能手机厂家出货量
- 2013年1月-2014年12月中国手机市场月度出货量
- 2014年中国智能手机市场主要厂家市场占有率
- 2014年中国4G手机市场主要厂家市场占有率
- 2011-2016年全球平板电脑出货量
- Top Five Tablet Vendors, Shipments Fourth Quarter 2014
- Top Five Tablet Vendors, Shipments, Market Share, and Growth, Calendar Year 2014
- 2008-2015年笔记本电脑出货量
- 2010-2014年全球主要笔记本电脑ODM厂家出货量
- 2012-2014年主要HDI厂家收入排名
- 2010-2013年NOKIA手机PCB供应商供应比例
- 2010-2013年SAMSUNG手机PCB供应商供应比例
- 2012年LG手机PCB供应商供应比例
- 2010-2013年ZTE手机PCB供应商供应比例



- 2010-2011年RIM手机PCB供应商供应比例
- 2010-2013年APPLE PCB供应商供应比例
- 2012-2014年主要HDI厂家收入排名
- 2014年1季度全球DRAM厂家收入排名
- 2014年1季度全球DRAM厂家市场占有率
- 2014年1季度NAND厂家市场占有率
- 2010-2013年内存PCB厂家市场占有率
- 2006\2010\2011\2012年光电板主要厂家市场占有率
- 2010-2014年汽车电子PCB厂家收入市场占有率
- 2011-2014年笔记本电脑PCB板主要厂家市场占有率（按出货量）
- 服务器PCB供应链
- 服务器PCB技术Roadmap
- 2014年全球服务器PCB主要厂家市场占有率
- 2012-2014年全球PCB硬板厂家收入前40名
- 2012-2014年主要PCB厂家毛利率
- 2012-2014年25大PCB厂家营业利润率
- 欣兴组织结构
- 2003-2014年欣兴收入与毛利率
- 2009-2014年欣兴收入与营业利润率
- 2012年1季度-2014年4季度欣兴季度收入与毛利率
- 2010-2014年欣兴销售额技术分布Sales Breakdown by Technology
- 2010-2014年欣兴收入下游应用分布Sales Breakdown by Application



- 2010-2014欣兴产能Capacity
- 2004-2013年欣兴CAPEX
- 2013年欣兴大陆子公司财务数据
- 2006-2014年华通收入与毛利率
- 2009-2014年华通收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月华通每月收入与增幅
- 2009-2013年华通主要子公司财务数据
- 瀚宇博德关系企业图
- 2006-2014年瀚宇博德收入与毛利率
- 2009-2014年瀚宇博德收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月瀚宇博月度收入与增幅
- 2009-2012年瀚宇博收入下游应用分布
- 2009-2012年瀚宇博收入Layer分布
- 2011年瀚宇博德主要子公司财务数据
- 2013年瀚宇博德主要子公司财务数据
- 2005-2015年金像电子收入与毛利率
- 2009-2014年金像电子收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月金像电子 每月收入与增幅
- 2010-2012年金像电子收入产品分布
- 2006-2014年健鼎收入与毛利率
- 2009-2015年健鼎收入与营业利润率
- 2013年健鼎收入by application



- 2013年健鼎收入by layer
- 2013年1月-2015年1月健鼎每月收入与增幅
- 2006-2011年健鼎产能
- 2013年健鼎大陆子公司财务数据
- 2006-2015财年名幸电子收入与运营利润率
- FY 2014名幸电子营业利润分析
- 2009-2014财年名幸电子大陆子公司收入与运营利润率
- 2015财年名幸电子大陆子公司收入与运营利润率
- 2013财年-2015财年名幸电子收入下游应用分布
- 2010财年-2015财年名幸电子收入技术分布by layer
- 2005-2015财年CMK收入与运营利润率
- 2007-2015财年CMK收入下游应用分布
- 2007-2015财年 CMK收入by layer
- 2007-2014财年 CMK收入地域分布
- 2003-2010年无锡希门凯收入与产量
- 2006-2015财年IBIDEN收入与运营利润率
- 2006-2015财年IBIDEN收入业务分布
- 2012年2季度-2014年2季度IBIDEN季度收入业务分布
- 2012年2季度-2014年2季度IBIDEN季度营业利润业务分布
- 2010-2015财年ibiden电子事业部收入产品分布
- 2010-2015财年ibiden CAPEX与depreciation
- 2005-2014年大德电子收入与运营利润率



- 2009-2014年大德电子收入by business
- 2005-2014年大德GDS收入与运营利润率
- 2010-2014年大德GDS收入业务分布
- 2005-2014年TTM收入与运营利润率
- TTM +Viasystems 收入下游分布
- 2013年1季度-2014年4季度TTM季度收入地域分布
- 2013年1季度-2014年4季度TTM季度收入与毛利率
- 2014年TTM客户分布
- 2011-2013年TTM收入地域分布
- 2013年TTM Revenues by technology
- 2008-2014年TTM收入下游应用分布
- TTM全球工厂分布
- 2006-2014年耀华收入与毛利率
- 2009-2015年耀华收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月耀华每月收入与增幅
- 硬板技术路线图
- 软硬板技术路线图
- 上海展华电子2010、2013 财务数据
- FY2005-FY2015 AT&S与EBITDA率
- AT&S重庆substrate厂 ramp
- FY2014 AT&S收入业务与地域分布
- FY2015 AT&S收入业务与地域分布



- Q2/13-Q4/14 AT&S Mobile Devices & Substrates业务季度收入
- AT&S Mobile Devices & Substrates业务主要客户
- Q2/13-Q4/14 AT&S Industrial & Automotive 业务季度收入
- 2010-2015 AT&S员工数量
- 2010-2015 AT&S CAPEX
- 建滔集团组织结构
- 2002-2014年建滔集团收入与股东应占利润率
- 2009-2014年建滔集团收入与税前利润率
- 2008-2014年建滔集团收入业务分布
- 依利安达组织结构
- 2005-2014年依利安达收入与运营利润率
- 2009-2013年依利安达资产负债表
- 2006-2013年依利安达收入地域分布
- 2006-2013年依利安达收入技术分布by layer
- 依利安达各厂产能
- 依利安达技术能力
- 2009-2013年Express Electronics东莞厂收入
- 2009-2013年Express Electronics苏州厂收入
- SIMM TECH组织结构
- 2004-2014年SIMMTECH收入与运营利润率
- 2009-2014年SIMMTECH收入、毛利率与净利率
- 2013-2015年SIMMTECH 收入产品分布



- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度毛利率与运营利润率
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度出货量
- 2012-2015年SIMMTECH出货量
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度产能利用率
- 2012-2015年SIMMTECH产能利用率
- 2008-2014年SIMMTECH收入by application
- 2012-2014年SIMMTECH Substrate收入by application
- SIMMTECH厂区
- 2005-2014年志超收入与毛利率
- 2005-2015年志超收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月志超每月收入与增幅
- 2014年志超客户结构
- 2014年志超收入下游分布
- TPT大陆子公司2013财务数据
- 依顿电子股权结构
- 2007-2014年依顿电子收入与毛利率
- 2009-2014年 依顿电子收入Layer分布
- 2009-2012H1 依顿电子收入by application
- 2009-2012依顿电子收入by Region
- 2005-2013年敬鹏收入与毛利率
- 2005-2015年敬鹏收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月敬鹏每月收入与增幅



- 2006-2015年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2012年1季度-2014年4季度LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2011-2015年LG INNOTEK 收入业务分布
- 2011-2015年LG INNOTEK 运营利润业务分布
- 2009-2014年SEMCO收入与营业利润率
- 2010-2014年SEMCO收入部门分布
- 2013年1季度-2014年4季度SEMCO ACI事业部收入与运营利润率
- 2014年1季度-2014年4季度SEMCO HDI 与PKG收入
- 2007-2014年方正PCB收入与运营利润率
- 2013年方正PCB子公司财务数据
- 2010年方正PCB下游应用分布
- 方正重庆厂产能
- 珠海方正一厂产能
- 珠海方正三厂产能
- 珠海方正五厂产能
- 方正杭州二厂产能by technology
- 珠海方正四厂产能
- 方正HDI技术能力
- 2005-2013年高德电子收入与运营利润
- 高德电子关系企业
- 2006-2014年定颖收入与毛利率
- 2009-2014年定颖收入与营业利润率



- 2013年1月-2015年1月定颖每月收入与增幅
- 2009-2012年定颖产能
- 2006-2014年惠亚收入与运营利润率
- 2008-2014年惠亚收入业务分布
- 惠亚全球分布
- 2008-2014惠亚集团收入下游应用分布
- 惠亚主要客户
- DDI收入地域和终端市场分布
- DDI工厂分布
- DDI主要客户
- 南亚电路板组织结构
- 2006-2014年南亚电路板收入与毛利率
- 2009-2015年南亚电路板收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月南亚电路板每月收入与增幅
- 南亚电路板产能与全球分布
- 深南电路技术能力
- 2007-2014年沪士电子收入与运营利润
- 2010-2014年沪士电子收入by layer
- 2007-2014年沪士电子收入下游分布
- 2012-2014年沪士电子毛利率by applicati
- 2013年沪士电子主要客户
- 2005-2014年超声电子收入与运营利润率



- 超声电子组织结构
- 2007-2014年超声电子收入业务分布
- 2007-2013年超声电子产量
- ZDT Holding Structure
- 2008-2015年臻鼎收入与运营利润率
- 2008-2014年臻鼎收入与毛利率
- 2013年1月-2015年1月ZDT月度收入
- ZDT Global Footprint
- 2006-2014 ZDT Number of Employees
- 2011-2013年Multek ELIC技术路线图
- 2011-2013年Multek 软硬板 技术路线图
- 2011-2013年Multek Microvias技术路线图
- 2004-2014年景硕收入与毛利率
- 2009-2015年景硕收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月景硕每月收入与增幅
- 2011-2014年景硕收入产品分布
- 2011年景硕收入下游应用分布
- Q1/2014景硕收入BY Applications
- Q4/2014景硕收入BY Applications
- 2013\2014 KINSUS客户分布
- FY207-FY2015 Shinko收入与净利润
- 2010-2015财年Shinko收入业务分布



- 2008-2014年ISU PETASYS收入与营业利润率
- 2012-2014年ISU PETASYS收入by technology
- 2011-2015年景旺电子收入与营业利润
- 2011-2014年景旺电子产能与产量
- 2011-2014年景旺电子收入by layer
- 2011-2014年景旺电子收入by end market
- 2011-2014年景旺电子产品ASP
- 2011-2014年景旺电子客户分布
- 2011-2014年景旺电子原材料成本结构
- 2011-2014年景旺电子原材料价格
- 2011-2014年景旺电子主要供应商
- 景旺电子2014年6月底主要设备
- 2009-2014年博智电子收入与毛利率
- 2009-2014年博智电子产品平均售价
- 2013年1月-2015年1月博智电子月度收入
- 2012-2014年博智电子出货量下游分布



购买报告

价 格	电子版: 9000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 9500元	传真: 010-8260.1570
页数: 190页	邮箱: hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期: 2015-3	网址: www.pday.com.cn	
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201503/24512926.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

